

Técnicas de depósito aplicado a la fabricación de dispositivos semiconductores

Microcredencial 3 ECTS (10h aula + 20h lab.)

CÁTEDRA UPM – INDRA en MICROELECTRÓNICA

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

1. Depósito de metales para contactos eléctricos en dispositivos de semiconductores:
 - i. Evaporación de metales por efecto Joule
 - ii. Evaporación de metales mediante haz de electrones
 - iii. Pulverización catódica
 - iv. Tratamientos térmicos: RTA, hornos de resistencias.
2. Depósito de materiales dieléctricos para aislamiento entre niveles de un chip:
 - i. Pulverización catódica
 - ii. Depósito químico en fase vapor (LP-CVD, PE-CVD e ICP-CVD)
 - iii. Depósito de capas de tamaño atómico (ALD)
 - iv. Oxidación térmica



**MATRÍCULA 100%
GRATUITA.
FINANCIADO POR
CÁTEDRA
UPM-INDRA**

🕒 10/01/2025 al 07/03/2025 (L y V) de 17:00h a 19:00h

📍 PRESENCIAL. Laboratorios del ISOM y aulas de la ETSI Telecomunicación

✉ comunidad.microelectronica@upm.es

PREINSCRÍBETE